

SMT/PCB &
NEPCON KOREA

www.smtpcb.org

2014 SMT/PCB 기술세미나

“차세대 SMT/PCB 도금기술”



일 시 | 2014년 4월 2일(수) 오전 10시
장 소 | 코엑스 컨퍼런스센터 3층 Hall E 5
주 최 | (사)한국마이크로전자 및 패키징학회

01 초대의 말씀

존경하는 회원 여러분

최근 국내외적 어려운 경제 여건을 감안할 때 IT 산업의 경쟁력 강화는 매우 필요한 시점이라 판단됩니다. IT 산업의 기술력 향상에는 반드시 미세 전자소자의 패키징 문제가 매우 중요한 기술요소로 인식되고 있습니다. 특히 국내의 SMT/PCB 업계를 중심으로 차세대 고성능, 고집적화와 고신뢰성을 가지는 패키징 기술 개발을 통해 국가 IT 산업의 경쟁력을 한 단계 업그레이드 시킬 수 있을 것입니다. 이에 본 학회는 회원사와 마이크로전자 및 패키징 관련 업계를 중심으로 새로운 기술을 확보하고 차세대 후속 상품 개발을 위해 이 분야의 핵심 기술의 trends와 애로기술에 대한 최근의 동향 발표와 토론을 통해 국내 산업이 나아가야 할 방향에 대한 길잡이 역할을 하고자 합니다.

IT 산업의 중심에 서 있는 스마트폰의 경쟁력은 발전하는 다기능의 소자와 더불어 assembly 공정과 PCB 기판 기술의 완벽한 조화가 요구되는 시점입니다.

금번에 본 학회에서 주최하는 세미나에서는 패키징 기술에 있어서 『차세대 SMT/PCB 도금기술』을 주제로 선정하여 업계, 학계 및 연구기관의 여러 전문가들을 모시고, Advanced Package기술과 관련된 도금 기술과 더불어 SMT/PCB 전반에 대한 기술 개발 방향 관련된 신뢰성 기술 등 심도 깊은 연구 개발 결과를 공유함으로써 기술 교류의 장을 제공하고자 하오니 관심 있는 많은 분들의 참석을 바랍니다.

(사)한국마이크로전자 및 패키징 학회장 **최창호**

02 조직위원

▶ 위 원 장

최창호(하나마이크론)

▶ 조직위원회

선용빈(경기대학교)

장호정(단국대학교)

이재호(홍익대학교)

정승부(성균관대학교)

고영주(대덕전자)

박영배(안동대학교)

이종현(서울과학기술대학교)

김영국(인하대학교)

김종헌(주네패스)

박상영(이오테크닉스)

유세훈(한국생산기술연구원)

이광주(LG화학)

임철홍(코리아써키트)

전기도(LG이노텍)

최광성(한국전자통신연구원)

03 프로그램

10:00~13:00 Registration

10:20~10:30 준비위원장 개회사 / 최창호 회장 (하나마이크론)

좌 장: 김영국 교수 (인하대학교)

10:30~11:00 1) 모바일기기 적용 Optical FPCB 기술동향
임영민 박사 (KETI)

11:00~11:30 2) 친환경 무주형 나노소재 전기도금
송재용 센터장 (한국표준과학연구원)

11:30~12:00 3) Study of New Final Finish Process
최성대 차장 (한국우에무라)

12:00~13:30 *Lunch*

좌 장: 고영주 이사 (대덕전자)

13:30~14:00 4) PKG PWB 의 현재 Trend 및 SAP Process
SHIMIZU Rikiya(Dow Chemical Japan)

14:00~14:30 5) 차세대 무전해 Pd/Au 도금기술 (EPAG)
이태호 전무이사 (MK Chem &Tech)

14:30~15:00 6) 반도체/PCB 최신 도금기술 동향
허육환 사장 (㈜익스텔)

15:00~15:20 *Coffee Break*

15:20~15:50 7) 감광성 SR 소재 개발과 내도금성 이슈
정우재 차장/최병주 과장 (LG화학)

15:50~16:20 8) TSV Gap-fill 특성 개선을 위한 씨앗층 습식 보강공정 소개
이민형 박사 (한국생산기술연구원)

16:20~16:50 9) 펄스 도금의 원리와 PCB에 응용
이재호 교수 (홍익대학교)

※ 본 프로그램은 사정에 의해 강사 및 내용이 일부 변경 될 수 있습니다.

04 안내말씀

▶ 참가비용

* 사전등록: 3월 28일(금)까지

- 정회원: 90,000원 / 비회원: 120,000원 / 학생: 40,000원

※ 입금처: 신한은행 140-000-943266

예금주: (사)한국마이크로전자 및 패키징학회

※ 성명, 소속, 연락처를 아래의 E-mail 로 송부한 후, 등록비 입금.
(본인 명의로 입금요망)

* 당일등록

- 정회원: 120,000원 / 비회원: 150,000원 / 학생: 50,000원

※ 프로시딩, 발표자료 CD, 중식 포함

※ 주차료 본인 부담

※ 사전등록 후, 현장 카드 결제 가능

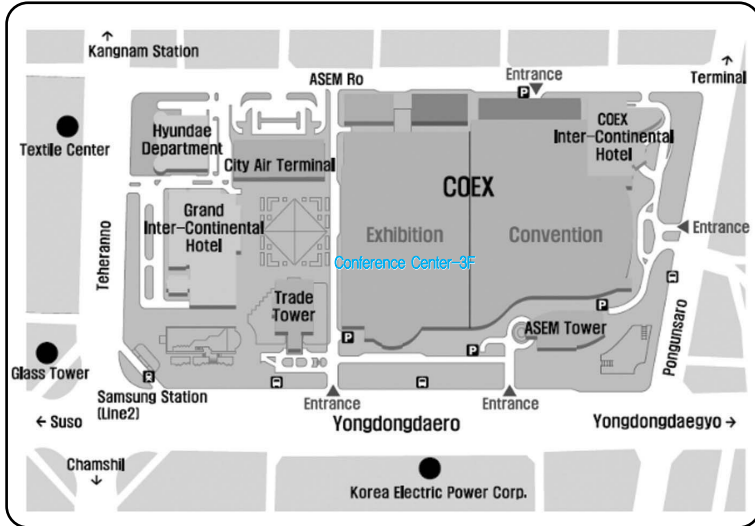
▶ 문의처

박소윤 간사(학회사무실)

Tel: 02-538-0962 Fax: 02-538-0963

E-mail: kmeps@kmeps.or.kr http://www.kmeps.or.kr

05 오시는 길



- ▶ COEX Conference Center Hall E5
Samsung-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea
<http://www.coex.co.kr>



서울시 강남구 테헤란로 7길 한국과학기술회관 본관 505호
TEL : (02) 538-0962 FAX : (02) 538-0963
E-mail : kmeps@kmeps.or.kr